

GWS-300R

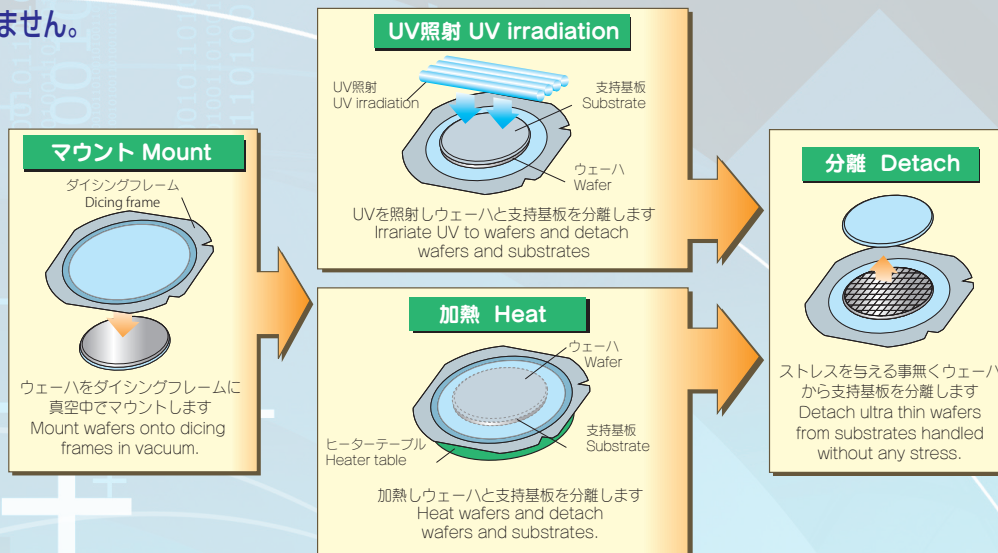
ウェーハ / 支持基板分離装置 WAFER/SUBSTRATE DETACHING MACHINE WITH MOUNTING FUNCTION

【概要 - Outline -】

◆本装置は、支持基板に貼付けられたウェーハを真空チャンバー内でマウントし、UV 照射又は加熱後、支持基板の分離を行います。
This machine mounts wafers which are attached with substrate in vacuum chamber, then irradiate UV (or heat), then detach wafers and substrates.

超薄厚ウェーハのハンドリング及びマウントはタカトリ独自の吸着エレメント、真空チャンバーの採用によりウェーハに
No stress to wafers by Takatori unique thin wafer handling, vacuum element, vacuum chamber.

ストレスを与えません。



仕様 Specification	GWS-300R
スループット Throughput	30~40 枚 /h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)
対応ウェーハサイズ Wafer Size	8・12 inch
装置寸法 Demension	W 2,300 × D 2,500 × H 1,800 mm
重量 Weight	1,400 (UV 200 kg 含む /Incl. 200 kg UV) kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.